

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-71

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	华福证券、摩根士丹利基金、国联基金、盈峰资本、蜂巢基金、长城基金、长盛基金
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年11月25日
地点	华福证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2024年第三季度PCB业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司PCB业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司PCB业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。</p> <p>Q2、请介绍AI领域的发展对公司PCB业务产生的影响。</p> <p>伴随AI技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热等PCB产品需求的提升。公司PCB业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI加速卡、存储器等领域的PCB产品需求均受到上述趋势的影响。</p>

Q3、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。

与传统汽车电子产品相比,公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高,工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高,涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现,汽车也可能演变为新型的移动数据终端,公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q4、请介绍公司 PCB 业务后续扩产规划。

公司为进一步拓展海外市场,满足国际客户需求,已在泰国投资建设工厂,总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中,具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。另一方面,公司在南通基地尚有土地储备,具备新厂房建设条件,南通四期项目已有序推进基建工程,拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况,合理配置业务产能。

Q5、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节,按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心,协同 PCB 业务,发挥公司电子互联产品技术平台优势,通过一站式解决方案平台,为客户提供持续增值服务,增强客户粘性。

Q6、请问公司电子装联业务是否仅面向 PCB 业务客户提供服务。

公司电子装联业务的服务对象不局限于现有 PCB 业务客户,两项主营业务客户群并不完全重叠。公司电子装联与 PCB 业务既实现彼此高效协同,也有在各自领域相继拓展。

Q7、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样,包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季度,封装基板下游市场需求有所放缓,公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。

	<p>Q8、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。</p> <p>公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p>Q9、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。</p> <p>Q10、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品特点以及主要应用场景。</p> <p>FC-BGA 封装基板具备高多层、高精度线路等特性，主要应用于搭载 CPU、GPU 等逻辑芯片，芯片产品具体应用场景取决于客户自身需求。</p> <p>Q11、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>